

北京赛微电子股份有限公司

证券代码:300456 证券简称:赛微电子 公告编号:2025-009

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

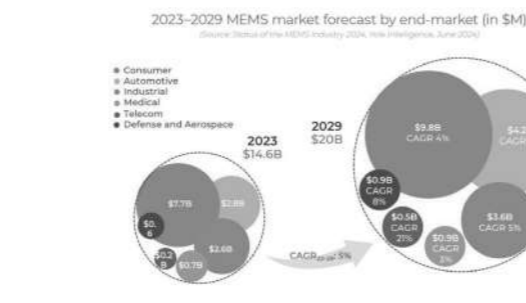
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所	注册地址	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡大道240号(原深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡大道240号)北京赛微电子股份有限公司
办公地址	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡大道240号(原深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡大道240号)北京赛微电子股份有限公司	办公电话	0755-27929292
传真	0755-27929292	电子邮箱	ir@semic.com.cn
网址	http://www.semic.com.cn	年度报告披露网站	http://www.semic.com.cn



图片来源:Yole Development

MEMS属于国家战略性新兴产业和战略性新兴产业,是当前国际竞争和科技发展的前沿热点。国家“十四五”规划明确提出,打造数字经济新优势,加强关键核心技术自主创新,聚焦传感器等关键领域,“与此同时,以高水平现代化生产方式(新型态、新结构、高技术、高质量、高效率、可持续的生产力)为衡量标准,以“领域新、技术含量高、依靠创新驱动”为评判标准,MEMS属于新生产力的范畴,将助力推动相关产业的发展,增强企业创新能力和国际竞争力。近年来,国家有关部门陆续出台了一系列相关政策,从关键技术研发、产业应用等角度大力支持进行产业发展,为行业的发展提供了良好的政策环境。

年份	营业收入(亿元)	净利润(亿元)	经营活动现金流量净额(亿元)
2024	120.47	12.41	12.41
2023	109.76	12.41	12.41
2022	109.76	12.41	12.41
2021	109.76	12.41	12.41
2020	109.76	12.41	12.41
2019	109.76	12.41	12.41
2018	109.76	12.41	12.41
2017	109.76	12.41	12.41
2016	109.76	12.41	12.41
2015	109.76	12.41	12.41
2014	109.76	12.41	12.41
2013	109.76	12.41	12.41
2012	109.76	12.41	12.41
2011	109.76	12.41	12.41
2010	109.76	12.41	12.41
2009	109.76	12.41	12.41
2008	109.76	12.41	12.41
2007	109.76	12.41	12.41
2006	109.76	12.41	12.41
2005	109.76	12.41	12.41
2004	109.76	12.41	12.41
2003	109.76	12.41	12.41
2002	109.76	12.41	12.41
2001	109.76	12.41	12.41
2000	109.76	12.41	12.41
1999	109.76	12.41	12.41
1998	109.76	12.41	12.41
1997	109.76	12.41	12.41
1996	109.76	12.41	12.41
1995	109.76	12.41	12.41
1994	109.76	12.41	12.41
1993	109.76	12.41	12.41
1992	109.76	12.41	12.41
1991	109.76	12.41	12.41
1990	109.76	12.41	12.41
1989	109.76	12.41	12.41
1988	109.76	12.41	12.41
1987	109.76	12.41	12.41
1986	109.76	12.41	12.41
1985	109.76	12.41	12.41
1984	109.76	12.41	12.41
1983	109.76	12.41	12.41
1982	109.76	12.41	12.41
1981	109.76	12.41	12.41
1980	109.76	12.41	12.41
1979	109.76	12.41	12.41
1978	109.76	12.41	12.41
1977	109.76	12.41	12.41
1976	109.76	12.41	12.41
1975	109.76	12.41	12.41
1974	109.76	12.41	12.41
1973	109.76	12.41	12.41
1972	109.76	12.41	12.41
1971	109.76	12.41	12.41
1970	109.76	12.41	12.41
1969	109.76	12.41	12.41
1968	109.76	12.41	12.41
1967	109.76	12.41	12.41
1966	109.76	12.41	12.41
1965	109.76	12.41	12.41
1964	109.76	12.41	12.41
1963	109.76	12.41	12.41
1962	109.76	12.41	12.41
1961	109.76	12.41	12.41
1960	109.76	12.41	12.41
1959	109.76	12.41	12.41
1958	109.76	12.41	12.41
1957	109.76	12.41	12.41
1956	109.76	12.41	12.41
1955	109.76	12.41	12.41
1954	109.76	12.41	12.41
1953	109.76	12.41	12.41
1952	109.76	12.41	12.41
1951	109.76	12.41	12.41
1950	109.76	12.41	12.41
1949	109.76	12.41	12.41
1948	109.76	12.41	12.41
1947	109.76	12.41	12.41
1946	109.76	12.41	12.41
1945	109.76	12.41	12.41
1944	109.76	12.41	12.41
1943	109.76	12.41	12.41
1942	109.76	12.41	12.41
1941	109.76	12.41	12.41
1940	109.76	12.41	12.41
1939	109.76	12.41	12.41
1938	109.76	12.41	12.41
1937	109.76	12.41	12.41
1936	109.76	12.41	12.41
1935	109.76	12.41	12.41
1934	109.76	12.41	12.41
1933	109.76	12.41	12.41
1932	109.76	12.41	12.41
1931	109.76	12.41	12.41
1930	109.76	12.41	12.41
1929	109.76	12.41	12.41
1928	109.76	12.41	12.41
1927	109.76	12.41	12.41
1926	109.76	12.41	12.41
1925	109.76	12.41	12.41
1924	109.76	12.41	12.41
1923	109.76	12.41	12.41
1922	109.76	12.41	12.41
1921	109.76	12.41	12.41
1920	109.76	12.41	12.41
1919	109.76	12.41	12.41
1918	109.76	12.41	12.41
1917	109.76	12.41	12.41
1916	109.76	12.41	12.41
1915	109.76	12.41	12.41
1914	109.76	12.41	12.41
1913	109.76	12.41	12.41
1912	109.76	12.41	12.41
1911	109.76	12.41	12.41
1910	109.76	12.41	12.41
1909	109.76	12.41	12.41
1908	109.76	12.41	12.41
1907	109.76	12.41	12.41
1906	109.76	12.41	12.41
1905	109.76	12.41	12.41
1904	109.76	12.41	12.41
1903	109.76	12.41	12.41
1902	109.76	12.41	12.41
1901	109.76	12.41	12.41
1900	109.76	12.41	12.41

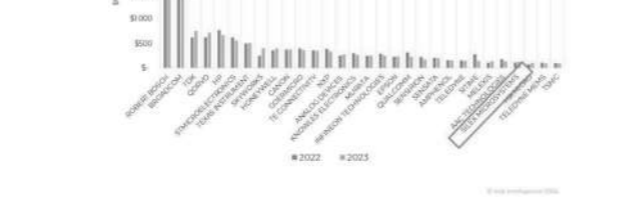
公司当前的核心业务为MEMS工艺开发及晶圆制造,因此,基于该细分行业整体发展长期向好的态势以及国家政策的长期支持,公司MEMS业务的进一步发展将继续拥有良好的产业发展及政策支持环境。报告期内,公司旗下控股子公司继续获得中央及地方集成电路项目的资金支持,有利于公司进一步加大相关投入,推动业务发展。

(三)国内外主要行业情况

MEMS芯片制造处于产业链的中游,该行业根据设计环节的需求开发各类MEMS芯片的工艺制程并实现规模生产,兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征,对企业的研发实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。经历汽车电子、消费电子、物联网三次发展浪潮,MEMS芯片制造行业已形成为稳定的市场竞争格局,瑞典Sioux、TELEDYNE、台积电(TSMC)、X-FAB长期保持在全球MEMS代工企业第一梯队,合计占据50%左右的市场份额。目前,公司控股子公司赛莱克斯在投资建设的规模量产“8英寸MEMS国际代工线”已投入运营,此外国内正在建设运营MEMS代工线公司主要有芯联集成电路制造股份有限公司、广州博志电子有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司、无锡华纳上华科技有限公司、上海华虹电子半导体制造有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司等。

(四)公司所处的行业地位

公司全资子公司瑞典Sioux是全球领先的纯MEMS代工企业,服务于全球各领域巨头厂商,正在合理预计扩产能,同时公司控股子公司赛莱克斯国际代工线已投入运营并持续推动产能爬坡,因此合理预计公司有望继续保持MEMS代工企业的全球领先地位。根据Yole Development的统计数据,截至2022年末,瑞典Sioux在全球MEMS代工厂商排名中一直位居第一,与意大利半导体(ST Microelectronics)、TELEDYNE、台积电(TSMC)、索尼(SONY)等厂商持续竞争,2019-2023年则在全球MEMS代工厂商中位居第一,在2023年全球MEMS厂商综合排名中居第21位。随着公司国内外新增产能及产线的陆续建设及投入使用,公司整体将继续保持在全球MEMS制造产业竞争中的第一梯队。



图片来源:Yole Development

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需调整前期披露或更正以前年度会计数据

项目	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
营业收入	120.47	109.76	109.76	109.76	109.76
归属于上市公司股东的净利润	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41
经营活动产生的现金流量净额	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41
研发投入	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41
研发投入占营业收入的比例	10.30%	11.22%	11.22%	11.22%	11.22%
研发投入资本化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
研发费用资本化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
研发费用占营业收入的比例	10.30%	11.22%	11.22%	11.22%	11.22%
研发费用占净利润的比例	82.27%	90.97%	90.97%	90.97%	90.97%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例	66.97%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占经营活动产生的现金流量净额的比例	98.47%	72.63%	72.63%	72.63%	72.63%
研发费用占归属于上市公司股东的净利润的比例	66.97%				